

適用規格					
定格	使用温度範囲	-55℃ ~ +125℃ (注6)	保存温度範囲	-10℃ ~ +60℃ (梱包状態)	
	電圧	AC/DC 50V	使用・保存湿度範囲	相対湿度90%以下 (結露しないこと)	
	電流	0.5 A	適合ケーブル (FPC/FFC)	t=0.33±0.03mm : 金めっき (GNDプレート : すずめっき)	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。(注1)	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的性能	耐電圧	AC 150Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
	絶縁抵抗	DC 100Vで測定する。	500MΩ以上	○	-
	接触抵抗	開回路電圧AC 20mV以下, 1mAで測定する。	[FPC]初期:60mΩ以下、試験後:80mΩ以下 (FPC導体抵抗8mm含む) [FFC]初期:80mΩ以下、試験後:100mΩ以下 (FFC導体抵抗26mm含む)	○	-
機械的性能	耐振性	周波数 10~55Hz, 片振幅 0.75mm, 3軸方向各10サイクル試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 80mΩ以下 (FPC), 100mΩ以下 (FFC) ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	衝撃	加速度 981m/s <sup>2</sup> , 持続時間 6ms, 正弦半波 3軸両方向各3回試験する。		○	-
	繰返し動作	10回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 80mΩ以下 (FPC), 100mΩ以下 (FFC) ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	FPC/FFC挿抜力	適合FPC/FFCで測定する。 (初期, FPC/FFC端末厚 t=0.33mm)	挿入力: 水平方向 (n:極数) 2 + 0.35 x n N以下 (注2) (FPC/FFC) 2 + 0.41 x n N以下 (注2) (ｼｰﾙﾄﾞ FFC) 抜去力: 水平方向 (n:極数) 4 + 0.32 x n N以下 (注2) (FPC/FFC) 4 + 0.42 x n N以下 (注2) (ｼｰﾙﾄﾞ FFC)	○	-
	FPC/FFC保持力	適合FPC/FFCで測定する。 (初期, FPC/FFC端末厚 t=0.33mm)	水平方向 (n:極数) 18 + 0.08 x n N以上 (注3) (FPC/FFC) 15 + 0.1 x n N以上 (注3) (ｼｰﾙﾄﾞ FFC)	○	-
環境的性能	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+125→+15→+35℃ 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3分 に 1000サイクル放置する。	① 接触抵抗: 80mΩ以下 (FPC), 100mΩ以下 (FFC) ② 絶縁抵抗: 50MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	定常状態の耐湿性	温度 60±2℃, 相対湿度 90~95%中に 96時間放置する。		○	-
	温湿度サイクルの耐湿性	温度 -10~+65℃, 相対湿度 90~96%中に 10サイクル (240時間) 放置する。	① 接触抵抗: 80mΩ以下 (FPC), 100mΩ以下 (FFC) ② 絶縁抵抗: 1MΩ以上 (高湿時) ③ 絶縁抵抗: 50MΩ以上 (乾燥時) ④ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐熱性	温度 125±2℃中に, 1000時間放置する。	① 接触抵抗: 80mΩ以下 (FPC), 100mΩ以下 (FFC) ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	-
	耐寒性	温度 -55±3℃中に, 1000時間放置する。		○	-
	二酸化硫黄 [JIS C 60068-2-42]	温度 40±2℃, 相対湿度 80±5%, 濃度 25±5ppmに, 96時間放置する。	① 接触抵抗: 80mΩ以下 (FPC), 100mΩ以下 (FFC)	○	-
	はんだ付け性	はんだ温度 245±3℃ 浸せき時間 3±0.3秒間のはんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の 95%以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	-
はんだ耐熱性	1) リフローの場合 ヒート温度 250℃MAX 220℃以上, 60~90秒、リフロー回数: 2回迄 2) はんだこての場合 350±10℃, 5±1秒間	外観の変形, 及び端子などに 著しいひびがないこと。(注4)	○	-	
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△4	1	DIS-F-00006186	KN. KOBAYASHI	HS. HIRAHARA	20200615
備考			承認	HH. SHINDO	20180517
試験規格の記載のない試験方法はIEC 60512 (対応規格 JIS C 5402) を適用している。 注1) 本品は、フュージョンロック (嵌合操作はFPC/FFC挿入のみ)、垂直接続タイプです。 FPC/FFC抜去が必要な場合のみ、ロケバ <sup>®</sup> の操作を実施してください。 注2) FPC/FFCは本品に対し、斜めに挿入/抜去しないようご注意ください。 注3) FPC/FFCに水平方向の荷重が加わる場合は、FPC/FFCを固定してご使用願います。 FPC/FFCの仕様により上記の値が変わる場合があります。 注4) モールドに若干ふくれが発生する場合がありますが、製品性能上問題ありません。 注5) ウィスカ <sup>®</sup> 発生有無、長さ、それを起因とする性能劣化については規格対象外になります。 注6) FFC使用時の耐熱温度は105℃となります。耐熱温度がFPC: 125℃未満、 FFC: 105℃未満の場合は、FPC・FFCの耐熱温度が適用となります。			検図	KN. SHIBUYA	20180517
			担当	SI. TAMAKI	20180516
			製図	DS. HIROWATARI	20180516
注	QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC-370364-00-00	
HRS	製品規格表		製品名	FH67-**S-0.5SV	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL580	△4   1/1